

パワーモジュールのパッケージ技術動向

高橋 良和*, 両角 朗*, 池田 良成*, 西村 芳孝*

Technical Trend of Packaging for Power Semiconductor Modules

Yoshikazu TAKAHASHI*, Akira MOROZUMI*, Yoshinari IKEDA*, and Yoshitaka NISHIMURA*

* 富士電機株式会社技術開発本部電子デバイス研究所次世代モジュール開発センターパッケージ開発部 (〒191-8502 東京都日野市富士町1番地)

* Package Development Div., Next Gen. Module Development Center, Electronic device Laboratory, Corporate R&D Headquarters, Fuji Electric Co., Ltd. (1, Fuji-machi, Hino, Tokyo 191-8502)